（上接B102版）

外，截至2025年12月31日，公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。截至2025年12月31日，保荐机构对晶合集成募集资金存放、管理与使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

不适用。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026年3月27日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份													
募集资金到账日期	2023年4月26日													
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)注1	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益注4	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
后照式CMOS图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含90纳米及55纳米）	研发	否	600,000,000.00	600,000,000.00	600,000,000.00	71,875,498.34	472,167,225.81	-127,832,774.19	78.69	2025年底	不适用	不适用	否
微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）	研发	是	350,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	终止	不适用	不适用	是
40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目注2	研发	否	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	99,640,759.99	1,176,243,549.77	-323,756,450.23	78.42	2025年中	不适用	不适用	否
28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目注3	研发	是	2,450,000,000.00	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	776,308,456.15	2,856,191,557.26	56,191,557.26	102.01	2025年底	不适用	不适用	否
收购制造基地厂房及厂务设施	生产建设	否	3,100,000,000.00	3,100,000,000.00	3,100,000,000.00	0.00	2,763,936,719.17	-336,063,280.83	89.16	2023年7月	不适用	不适用	否
补充流动资金及偿还贷款	补流还贷	否	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	0.00	1,517,274,213.08	17,274,213.08	101.15	不适用	不适用	不适用	否
超募资金－永久补充流动资金	补流还贷	-	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	不适用
超募资金－回购公司股份	回购公司股份	-	0.00	163,516,459.91	163,516,459.91	0.00	164,520,697.56	1,004,237.65	100.61	不适用	不适用	不适用	不适用
合计			9,500,000,000.00	9,723,516,459.91	9,723,516,459.91	947,824,714.48	9,010,333,962.65	-713,182,497.26	—	—	不适用	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	详见本专项报告“四、变更募投项目的资金使用情况”。												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（七）节余募集资金使用情况”。												
募集资金其他使用情况	详见本专项报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“（八）募集资金使用的其他情况”。												

注1：“截至期末累计投入金额”包含：直接投入募集资金项目的金额；以募集资金置换预先投入项目的自筹资金金额；使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额；超募资金永久补充流动资金金额，超募资金回购公司股份金额。

注2：公司终止“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）”并将该项目募集资金投向变更至“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”，此处“调整后投资总额”不含“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）”募集资金实际转出时的利息收入。

注3：公司于2026年2月6日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意将募投项目“后照式CMOS图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含90纳米及55纳米）”“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”结项，具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-001）。

注4：上述募投项目均不直接产生效益，无法单独核算效益。募投项目“后照式CMOS图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含90纳米及55纳米）”、“40纳米逻辑芯片工艺平台研发项目”及“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”主要是为了进一步增强公司的研发实力，提高公司的产品市场竞争力，提升公司的持续盈利能力与核心竞争力。“收购制造基地厂房及厂务设施”主要是为了保障生产自主性与资产完整性，降低长期运营成本。“补充流动资金及偿还贷款”项目成果体现在缓解公司资金压力，降低财务风险。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元币种：人民币

发行名称	2023年首次公开发行股份														
募集资金到账日期	2023年4月26日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目	微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）	研发	晶合集成	安徽省合肥市	2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	776,308,456.15	2,856,191,557.26	102.01	2025年底	不适用	不适用	否	2024年12月30日	2025年5月28日
合计					2,800,000,000.00	2,800,000,000.00	776,308,456.15	2,856,191,557.26	-	-	不适用	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	受主轴产品研发策略和市场需求变化的影响，公司从市场需求、技术投入、投资收益以及成本控制等多个维度重新对募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）”进行评估，认为该项目效益相较于最初预期出现了明显的降低趋势。公司决定整合研发资源并聚焦于公司主力产品，将更多研发力量投向效益更好的研发项目上。28纳米逻辑及OLED芯片作为市场上展现出巨大的需求潜力，并且公司“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”的开发进展顺利，目前已取得了良好的阶段性成果，公司明显通过扩大投资额，加快推动28nm产品的工艺精进及效能提升，以满足客户日益增长且不断变化的需求。鉴于上述情况，公司经慎重考虑决定将上募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）”，并将该项目募集资金变更投向至其他募投项目“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”的投资总额。本次变更募投项目有利于更快实现效益，机属产品的应用领域，使公司在微控的市场竞争中占据更有利的地位，符合公司实际经营需要，具有合理性和必要性。 公司于2024年12月30日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，董事会同意本次终止募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含55纳米及40纳米）”，并将该项目拟投入募集资金36,505.85万元（含现金管理收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户的募集资金余额为准）变更投向至其他募投项目“28纳米逻辑及OLED芯片工艺平台研发项目”，并授权公司管理层及其授权人士在股东会审议通过本次事项后办理开立募集资金专用账户及签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无异议的核查意见，该事项已于2025年5月28日经公司2024年年度股东会审议通过。														
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：688249　　证券简称：晶合集成　　公告编号：2026-005

合肥晶合集成电路股份有限公司关于拟对外投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”或“晶合集成”）拟使用不超过3亿元人民币的自有资金认购挂钩境外标的基金表现（以下简称“挂钩标的基金”）的银行结构性存款产品。该挂钩标的基金专项用于参与认购华勤技术股份有限公司（以下简称“华勤技术”）拟在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）首次公开发行并上市的H股股份。挂钩标的基金拟与华勤技术及其承销商签署《基石投资协议》，作为本次H股发行的基石投资者认购不超过3亿元人民币等值港元，认购股份的禁售期为华勤技术H股上市之日起六个月。

●华勤技术为公司持股5%以上股东，并且华勤技术实际控制人邱文生先生担任公司董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定，本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，交易实施不存在重大法律障碍。

●截至本公告披露日，除上述关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。本次交易无需提交股东会审议。

●本次关联交易已经公司第二届董事会独立董事专门会议第九次会议、第二届董事会第三十二次会议审议通过，保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。

●华勤技术本次香港首次公开发行事宜尚待获得香港联交所的最终正式批准，能否获得批准及获得批准的时间存在不确定性，存在不能成功发行的风险。挂钩标的基金的实际认购金额以其最终签署的《基石投资协议》约定为准。本次投资的产品类型为非保本浮动收益结构性存款，系高风险产品，挂钩标的基金专项用于参与认购华勤技术拟在香港联交所首次公开发行并上市的H股股份，受宏观经济政策、行业环境、标的公司经营业绩、汇率波动以及资本市场波动等多方面因素影响，公司收益存在不确定性，特定情形下可能损失部分或全部本金。敬请广大投资者注意投资风险。

一、关联交易概述

（一）本次交易的基本概况

1、本次交易概况

华勤技术是全球领先的智能产品平台型企业，系多家国内外知名终端厂商的重要供应商，是智能手机和平板电脑ODM领域的全球龙头企业，与晶合集成在产品布局、终端客户、全产业链合作等方面具有高度业务协同。

晶合集成拟使用不超过3亿元人民币的自有资金认购挂钩境外标的基金表现的银行结构性存款产品。该挂钩标的基金专项用于参与认购华勤技术拟在香港联交所首次公开发行并上市的H股股份。挂钩标的基金拟与华勤技术及其承销商签署《基石投资协议》，作为本次H股发行的基石投资者认购不超过3亿元人民币等值港元，认购股份的禁售期为华勤技术H股上市之日起六个月。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 □增资现有公司（□同比例□非同比例） 一-增资前标的公司类型：□全资子公司□控股子公司□参股公司□未持股公司 □投资新项目 √其他：认购挂钩境外标的基金表现的银行结构性存款产品
投资标的名称	华勤技术首次公开发行H股股份
投资金额	√已确定，具体金额：不超过3亿元人民币 □尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他： □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是√否

注：公司认购挂钩境外标的基金表现的银行结构性存款产品的资金不跨境。

（二）董事会审议情况，是否需经股东会审议通过和有关部门批准

公司于2026年3月26日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》，关联董事邱文生先生已回避表决。同时董事会授权公司管理层或其授权人员负责办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署相关协议等。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《合肥晶合集成电路股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，本次交易金额未达到股东会审议标准，无需提交公司股东会审议。

（三）明确说明是否属于关联交易和重大资产重组事项

华勤技术为公司持股5%以上股东，并且华勤技术实际控制人邱文生先生担任公司董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，交易实施不存在重大法律障碍。

（四）截至本公告披露日，除上述关联交易外，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人进行的同一交易类别下标的相关的交易未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上。

二、关联人暨交易标的基本情况

（一）关联人暨交易标的概况

法人/组织全称	华勤技术股份有限公司
统一社会信用代码	√91310115779776581R □不适用
法定代表人	邱文生
成立日期	2006/08/29
注册资本	101,573.2344万元人民币
实缴资本	101,573.2344万元人民币
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区科苑路399号1幢
主要办公地址	上海市浦东新区瑞科路600号华勤全球研发中心
主要股东/实际控制人	上海奥勤信息科技有限公司/邱文生
主营业务	一般项目：从事计算机软件领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、通讯产品及相关软硬件的设计、销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 √董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 √其他，持有晶合集成5%以上股份的股东

（二）华勤技术最近一年财务数据

单位：万元

科目	2025年12月31日（经审计）
资产总额	9,620,562.80
负债总额	6,986,030.17
所有者权益总额	2,634,532.64
资产负债率	72.62%
科目	2025年度（经审计）
营业收入	17,143,692.67
净利润	410,452.93

（三）关联关系说明

华勤技术为持有公司5%以上股份的股东，并且华勤技术实际控制人邱文生先生担任公司董事。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定，华勤技术为公司关联方，出于谨慎性以及实质重于形式考虑，本次交易构成关联交易。

（四）出资方式及相关情况

本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及使用募集资金。

（五）其他说明

华勤技术不是失信被执行人，其公司章程不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

三、本次关联交易的定价情况

华勤技术本次香港首次公开发行将根据投资者及市场反馈确定发行价格区间，并根据届时华勤技术正式刊发的法律文件中载列的价格区间及启动发行后的投资者订单情况在发行价格区间内确定最终发行价格，所有拟参与华勤技术本次香港首次公开发行的投资者最终认购价格一致。此次关联交易定价公允，符合交易公平原则，并按照相关规定履行批准程序，不存在损害公司利益及其他股东特别是中小股东利益的情况。

四、协议的主要内容

1、订约方

结构性存款发行人：华侨银行有限公司

投资者：合肥晶合集成电路股份有限公司

2、本结构性存款所募集资金100%纳入银行表内核算，按照存款管理，同时本结构性存款通过挂钩境外标的基金表现的金融衍生工具，在承担一定风险的基础上获得相应的收益。

3、产品类型：非保本浮动收益结构性存款。

4、挂钩标的基金的投资方向：主要为华勤技术拟在香港联交所首次公开发行并上市的H股股份。

5、结构性存款投资币种：人民币

6、结构性存款投资本金金额：以起始日结构性存款确认通知上约定的投资本金金额为准。

五、本次关联交易对上市公司的影响

华勤技术作为全球领先的智能硬件ODM厂商，产品线覆盖移动终端、笔电、数据中心、AIOT、汽车电子、机器人等多元化业务，服务于包括消费电子、数据中心、汽车电子等各类细分领域的科技公司。而晶合集成作为半导体晶圆制造企业，代工产品主要应用于消费电子、汽车电子、工业控制等领域，与华勤技术在产品布局、终端客户、全产业链合作等方面具有高度业务协同。本次投资符合公司长期战略发展方向，有利于深化产业链上下游合作，加强终端客户服务，发挥双方在资源整合、业务拓展、产业资讯共享等方面协同优势，助力公司精准优化产能布局与产品规划，降低经营决策风险，夯实公司可持续发展基础与综合竞争力。

本次交易的资金来源为公司自有资金，不会影响公司日常的资金周转，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次交易事项遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

六、本次关联交易的风险提示

华勤技术本次香港首次公开发行事宜尚待获得香港联交所的最终正式批准，能否获得批准及获得批准的时间存在不确定性，存在不能成功发行的风险。挂钩标的基金的实际认购金额以其最终签署的《基石投资协议》约定为准。本次投资的产品类型为非保本浮动收益结构性存款，系高风险产品，挂钩标的基金专项用于参与认购华勤技术拟在香港联交所首次公开发行并上市的H股股份，受宏观经济政策、行业环境、标的公司经营业绩、汇率波动以及资本市场波动等多方面因素影响，公司收益存在不确定性，特定情形下可能损失部分或全部本金。敬请广大投资者注意投资风险。

七、该关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2026年3月26日召开第二届董事会独立董事专门会议第九次会议，独立董事审核意见：公司本次拟对外投资暨关联交易事项，遵循自愿、公平和公开的原则，有利于提升公司的可持续发展能力，符合公司战略发展的需要。本次关联交易对公司日常经营及财务状况不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合有关法律法规及《公司章程》等规定。因此，独立董事一致同意公司拟对外投资暨关联交易事项并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议及表决情况

公司于2026年3月26日召开第二届董事会第三十二次会议，以8票同意、0票弃权、1票回避的表决结果审议通过了《关于公司拟对外投资暨关联交易的议案》，董事会同意本次公司拟对外投资暨关联交易事项，并授权董事长或其授权人员全权办理本次认购华勤技术拟在香港联交所首次公开发行并上市的H股股份，包括但不限于决定投资方式、签署认购股份相关协议等。关联董事邱文生先生已回避表决。上述议案无需提交公司股东会审议。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟对外投资暨关联交易事项已由公司独立董事专门会议事前审议通过，并经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，关联董事已回避表决，无需提交股东会审议。上述关联交易事项的审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次拟对外投资暨关联交易事项无异议。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2026年3月27日

证券代码：688249　　证券简称：晶合集成

合肥晶合集成电路股份有限公司2025年度可持续发展报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于可持续发展报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读可持续发展报告全文。

2、本可持续发展报告经公司董事会审议通过。

3、中国企业社会责任报告评级专家委员会为《合肥晶合集成电路股份有限公司2025年度可持续发展报告报告》全文出具了评级报告，经评级小组评价，《合肥晶合集成电路股份有限公司2025年度可持续发展报告》为五星级。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688249
公司简称	晶合集成
公司名称	合肥晶合集成电路股份有限公司
报告范围	合并报表范围
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制》、《可持续发展报告指南标准3（GRI Standards 2021）、气候相关财务信息披露工作组（简称“TCFD”）披露框架、香港联交所《主板及GEM上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告守则》

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、战略与ESG委员会、ESG推行委员会□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为相关业务部门每季度通过PPT报告方式向ESG推行委员会汇报可持续发展信息，ESG相关议题信息内部报告频率依据议题重要程度不同而设置不同报告频率，从季度至年度不等，其中ESG报告为年度报告。□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为《战略与ESG委员会工作规则》《ESG管理手册》□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
股东/投资者	持续研发投入、加强产品质量、健全治理体系、规范定期信披、落实廉洁培训	● 董事会/股东会 ● 投资者调研接待 ● 财务报告（季度） ● 业绩说明会 ● 证券交易所投资者关系互动平台 ● 公告及其他信息披露 ● 投资者关系联系电话、电子邮件
客户	供应链安全、创新驱动、产品和服务安全与质量、环境合规管理、数据安全与客户隐私保护	● 客户满意度调查 ● 客户拜访 ● 电话、电子邮件、即时通讯工具 ● 客户问卷调查 ● 线上会议
供应商/承揽商	供应链安全、知识产权保护、环境合规管理、有害物质管理、施工作业管理、产品和服务安全与质量	● 供应商遴选 ● 供应商稽核 ● 采购SRM系统 ● 承揽商系统 ● 供应商评优大会（年度） ● 供应商投诉处置 ● 承揽商评鉴（年度） ● 电话、电子邮件、即时通讯工具 ● 供应商不使用冲突矿产、不使用有害物质承诺书
员工	劳工权益维护、薪酬和福利、办公环境、培训机会、职业发展	● 工会智慧平台小程序 ● 员工满意度调查（年度） ● 职工代表大会（年度） ● HR 员工面对面沟通会 ● 员工在线沟通窗口 ● 困难员工帮扶和公益捐赠
政府/监管机构	创新驱动、环境合规管理、污染物排放、安全生产监管、反商业贿赂及反贪污、产品和服务安全与质量	● 政府项目申报（年度） ● 政策咨询热线 ● 政府监管部门例行监督检查 ● 开展专题调研与现场会 ● 官方媒体往来 ● 参与政府日常汇报沟通会
社区/环境	合规监管、社会服务、环境合规管理、生态系统和生物多样性保护	● 街道/社区志愿公益活动参与 ● 街道/社区监督检查 ● 环境信息披露 ● ESG报告发布（年度）

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
2	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
3	供应链安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
4	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
5	能源利用	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	能源利用
6	职业健康与安全	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	员工
7	知识产权保护	√财务重要性 □影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
8	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
9	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
10	水资源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	水资源利用
11	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
12	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反商业贿赂及反贪污
13	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
14	危害物质管控	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
15	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
16	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》规定的议题对公司不具有重要性的有7个：利益相关方沟通、尽职调查、平等对待中小企业、社会贡献、科技伦理、生态系统和生物多样性保护、乡村振兴，上述议题均根据实际情况适当披露或说明（具体内容详见报告全文）。

证券代码：688249　　证券简称：晶合集成　　公告编号：2026-004

合肥晶合集成电路股份有限公司关于预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：本次预计2026年度发生的关联交易为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，是以公司正常经营业务为基础，以市场价格为依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因关联交易对关联人产生依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2026年3月26日召开了第二届董事会独立董事专门会议第九次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易及对2025年度关联交易予以确认的议案》，并形成以下意见：公司预计2026年度日常关联交易额度及对2025年度关联交易的确认是基于公司业务发展及生产经营的需要，具有合理性与必要性，公司日常关联交易计划遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此对关联人形成依赖，不会对公司的独立性造成影响。独立董事一致同意公司2026年度日常关联交易额度预计及2025年度关联交易确认事宜并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司于2026年3月26日召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于预计公司2026年度日常关联交易及对2025年度关联交易予以确认的议案》。2026年日常关联交易预计金额合计为50,300.00万元。关联董事蔡国智先生、陆勤航先生、陈小蓓女士、郭兆志先生及朱才伟先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

加上本次预计的关联交易额度，过去12个月内，除已经公司股东会审议批准的关联交易事项外，公司及其子公司与同一关联人之间的关联交易金额累计未达到公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，无需提交公司股东会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至2026年2月底与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品、原材料、零配件等	合肥方晶科技有限公司及其子公司	12,000.00	1.10	478.06	1,582.03	0.15	因关联方产能扩充需要，预计销售量增加
	安徽晶镁光罩有限公司及其子公司	13,000.00	1.19	479.92	2,744.11	0.25	因关联方产能扩充需要，预计销售量增加
向关联方采购商品及接受劳务	合肥合燃华润燃气有限公司	3,100.00	5.45	429.85	2,388.64	4.20	-
	合肥水务集团有限公司	3,700.00	6.51	420.81	2,359.31	4.15	-
	智成电子股份有限公司	700.00	3.93	48.08	634.22	3.56	-
	安徽晶镁光罩有限公司及其子公司	16,000.00	95.83	575.62	2,243.86	13.44	因公司业务需求，预计光罩采购量增加。
关联租赁	合肥市安居控股集团股份有限公司	700.00	12.49	105.52	550.91	9.83	-
	合肥方晶科技有限公司	100.00	1.78	9.46	9.59	0.17	-
其他关联交易	安徽晶镁光罩有限公司及其子公司	1,000.00	227.72	136.63	439.14	100.00	-
合计		50,300.00	-	2,683.97	12,951.80	-	-

注1：上述金额占同类业务比例的分母为2025年度同类业务金额（经审计）；

注2：在上述关联交易总额范围内，公司及其子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联人之间的关联交易金额实现内部调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）；

注3：其他关联交易系关联人在租赁公司资产过程中发生的相关费用，如向公司支付的杂项购置费、修缮费等；

注4：若上述数据出现尾数不一致的情况，为四舍五入原因。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	2025年预计金额	2025年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售商品、原材料、零配件等	合肥方晶科技有限公司及其子公司	4,500.00	1,582.03	-
	安徽晶镁光罩有限公司及其子公司	3,400.00	2,744.11	-
向关联方采购商品及接受劳务	合肥合燃华润燃气有限公司	4,000.00	2,388.64	-
	合肥水务集团有限公司	3,800.00	2,359.31	-
	智成电子股份有限公司	1,500.00	634.22	-
	安徽晶镁光罩有限公司及其子公司	4,400.00	2,243.86	-
关联租赁	合肥市安居控股集团股份有限公司	1,000.00	550.91	-
	合肥方晶科技有限公司	50.00	9.59	-
其他关联交易	安徽晶镁光罩有限公司及其子公司	2,200.00	439.14	-
合计		24,850.00	12,951.80	-

注1：2025年实际发生数据经审计；

注2：公司于2025年4月18日召开第二届董事会独立董事专门会议第五次会议、第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议，并于2025年5月28日召开2024年年度股东会审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易及对2024年度关联交易予以确认的议案》；公司于2025年8月28日召开第二届董事会独立董事专门会议第七次会议、第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第十五次会议，并于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）合肥方晶科技有限公司（以下简称“方晶科技”）

1、关联人基本情况

统一社会信用代码	91340100MADUL5FRZT
企业类型	其他有限责任公司
成立日期	2024年7月29日
注册资本	30,000万元人民币
法定代表人	黄音德
注册地址	安徽省合肥市高新区长宁社区服务中心望江西路980号科创中心B座4层412室
经营范围	一般项目：半导体分立器件制造；半导体照明器件制造；集成电路制造；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；电子专用材料研发；半导体分立器件销售；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
股东情况	1.合肥晶合集成电路股份有限公司持股26.6667% 2.合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业（有限合伙）持股12.5000% 3.合肥瑞新控股集团有限公司持股12.5000% 4.合肥泽利企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股8.3333% 5.合肥泽明企业管理合伙企业（有限合伙）持股7.3333% 6.合肥泽恒企业管理合伙企业（有限合伙）持股6.6667% 7.合肥晶汇聚芯投资基金合伙企业（有限合伙）持股6.6667% 8.苏州嵩安创业投资合伙企业（有限合伙）持股6.6667% 9.合肥泽利企业管理合伙企业（有限合伙）持股4.3333% 10.合肥泽芯企业管理合伙企业（有限合伙）持股2.3333% 11.芜湖市瑞丞战新产业壹号基金合伙企业（有限合伙）持股1.6667% 12.杰后特微电子（杭州）有限公司持股1.6667% 13.合肥蔚来产业发展股权投资合伙企业（有限合伙）持股1.6667% 14.